

招商证券股份有限公司
关于拓荆科技股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为拓荆科技持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责拓荆科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与拓荆科技签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解拓荆科技业务情况，对拓荆科技开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2024 年度，拓荆科技在持续督导期间内未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2024 年度，拓荆科技在持续督导期间内未发生违法违规或违背承诺等事项。

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	2024 年度的持续督导期间内，保荐机构督导拓荆科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促拓荆科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对拓荆科技的内部控制度的设计、实施和有效性进行了核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，拓荆科技的内部控制制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促拓荆科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对拓荆科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2024 年度，拓荆科技无控股股东及实际控制人，拓荆科技第一大股东、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等	2024 年度，拓荆科技无控股股东及实际控制人，拓荆科技及

序号	工作内容	持续督导情况
	未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	其第一大股东不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2024 年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2024 年度，拓荆科技未发生前述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。 上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。 本持续督导期间，拓荆科技不存在前述需要进行专项现场检查的相关情形。

二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况

保荐机构持续督导人员对公司 2024 年度的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，拓荆科技严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2024 年度，保荐机构和保荐代表人未发现拓荆科技存在重大问题。

四、重大风险事项

公司面临的主要重大风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

随着半导体行业技术的发展和迭代，下游客户对半导体设备种类及性能的需求也随之变化。因此，公司需要持续保持较高的研发投入，保持产品的核心竞争力和先进水平。如果公司未来未能准确理解下游客户的产线设备及工艺技术演进需求，或者技术创新产品不能契合客户需求，可能导致公司设备无法满足下游产线生产制造需要，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。

公司建立了科学的研发体系，并具备先进技术的自主研发和创新能力，且技术创新紧跟市场需求，研发立项以客户需求为导向，始终与客户保持持续有效沟通，以避免可能的技术研发失败给公司带来损失。

（二）经营风险

1、产品验收周期较长风险

薄膜沉积设备所沉积的薄膜技术参数直接影响芯片性能。生产中不仅需要在成膜后检测薄膜厚度、均匀性、光学系数、机械应力及颗粒度等性能指标，还需要在完成晶圆生产流程及芯片封装后，对最终芯片产品进行可靠性和生命周期测试，以衡量薄膜沉积设备是否最终满足技术标准。因此，晶圆厂对薄膜沉积设备所需要的验证时间较长。同时，公司应用于三维集成领域的先进键合设备作为高精度专用装备，键合精度达百纳米级，当前仍处于产业化初期，是高带宽存储器、三维闪存芯片、3D DRAM、异构集成芯片等领域的核心支撑技术。由于部分产业应用尚未完成规模化验证，存在定制化需求攀升的技术风险，可能引致研发投

入超预期增长及验证周期延长，导致公司收入确认及回款周期延后，加剧资金链压力，对财务稳健性构成潜在风险。

随着公司产品在集成电路制造产线的应用规模逐步扩大，公司新平台、新工艺产品技术日益成熟，以及公司与客户高效稳定的合作下，产品的验证周期将呈缩短趋势。公司将持续关注公司的产品验证和回款情况，保证公司经营持续健康发展。

2、市场竞争风险

目前公司的竞争对手主要为国际知名半导体设备制造商，与中国大陆半导体专用设备企业相比，国际巨头企业拥有客户端先发优势，公司的综合竞争力处于弱势地位，市场占有率较低。另外，国内半导体设备厂商也进入公司业务领域开发部分同类产品。公司面临国际巨头以及潜在国内新进入者的双重竞争。如果公司未来无法持续有效应对市场竞争环境，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。

公司将持续关注国外竞争对手的发展，通过持续有效的研发投入不断缩短与国外厂商的技术代差，同时公司也密切关注国内竞争格局，不断扩大公司产品覆盖面，提升产品核心竞争力；公司亦将时刻关注行业竞争态势，科学合理的设定研发方向，加快研发进度，构筑较高的行业进入壁垒；同时，公司也将与客户保持更加紧密的合作，实现与下游客户的共同成长。

3、晶圆厂扩产不及预期的风险

下游晶圆厂产能规模决定了半导体专用设备的市场空间。晶圆厂的扩产投资具有一定的周期性。如果下游晶圆厂的投资强度降低，公司将面临市场需求下降的风险，对于公司的经营业绩会造成不利影响。

公司将随时关注半导体行业周期的发展阶段，根据市场情况统筹公司购、产、销各个环节，保持公司的经营活动与行业周期的协调；同时，公司将积极拓展客户群体，实现客户结构的多元化，避免因个别客户扩产不及预期造成重大不利影响。

4、供应链安全风险

近年来，复杂的国际形势加剧了全球供应链的不稳定性。目前，公司的部分零部件暂时仍然需要向国外供应商采购。如果国际贸易摩擦进一步加剧，可能出现上述国外供应商受相关政策影响减少或者停止对公司零部件的供应，可能会影响公司产品生产能力、生产进度和交货时间，降低公司的市场竞争力。

公司与供应商积极开展更深入、更广泛的合作，采取全球化、多货源的供应策略，构建稳定的合作渠道，以加强自身供应链安全，降低国际产业链不稳定所带来的风险。

（三）财务风险

1、政府补助政策变动风险

公司在 2024 年收到的政府补助主要是对公司研发投入的支持。如果公司未来不能持续获得政府补助，或政府补助显著降低，公司将需要投入更多自筹资金用于研发，进而影响公司现金流。此外，政府补助的减少，也会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

公司将持续扩大经营业务规模，提高盈利能力，以逐渐降低政府补助对公司经营业绩的影响。

2、税收优惠风险

2024 年，公司享受高新技术企业所得税及国家关于集成电路领域的相关税收优惠政策，如果国家上述税收优惠政策发生变化，则可能面临因税收优惠减少或取消而降低盈利的风险。

随着公司盈利能力不断增强，市场占有率扩大及产品竞争力的持续提高，税收优惠政策变动对公司经营业绩带来的影响正逐步降低。

（四）行业风险

半导体行业受半导体技术迭代、终端消费市场需求影响，呈现周期性波动。如果下游终端市场需求或发展不及预期、终端消费供需结构变化较大时，下游晶圆厂会调整其资本性支出规模和设备采购量，从而对公司经营情况产生影响。

公司将随时关注行业动态及景气度波动情况，提前预判并统筹公司的经营活动，合理控制现金流，避免行业波动造成重大不利影响。

（五）宏观环境风险

近期美国推行的关税政策预计将对全球经济产生深远影响，全球贸易体系与秩序遭受冲击，全球经济面临显著下行压力，全球半导体行业增长速度及供应链体系预计将受到影响，继而影响半导体设备行业的市场需求。

公司将密切关注国际贸易政策动向，采取灵活应对策略，同时，公司将紧抓国内半导体行业发展机遇，最大限度降低关税政策变动对公司业务发展的不利影响。

五、重大违规事项

2024 年度，公司不存在重大违规事项。

六、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司经审计的主要会计数据及财务指标如下所示：

（一）主要会计数据

单位：元人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减（%）	2022年
营业收入	4,103,453,853.41	2,704,974,035.48	51.70	1,705,562,723.82
归属于上市公司股东的净利润	688,154,723.26	662,583,836.09	3.86	368,470,797.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,137,942.78	312,119,681.34	14.10	178,057,348.30
经营活动产生的现金流量净额	-282,525,331.06	-1,657,342,652.77	不适用	247,625,867.82
主要会计数据	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减（%）	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	5,280,154,359.39	4,593,860,407.52	14.94	3,711,485,492.51
总资产	15,314,166,086.88	9,969,345,254.15	53.61	7,313,735,941.18

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减（%）	2022年
基本每股收益（元 / 股）	2.48	2.39	3.77	1.45
稀释每股收益（元 / 股）	2.46	2.38	3.36	1.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.28	1.13	13.27	0.70
加权平均净资产收益率（%）	14.11	16.09	减少1.98个百分点	13.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.30	7.58	减少0.28个百分点	6.34
研发投入占营业收入的比例（%）	18.42	21.29	减少2.87个百分点	22.21

注：根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司以股权登记日 2024 年 6 月 7 日收盘后公司总股本扣减回购专用证券账户中的股份总数为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.48 股，前述资本公积转增股本实施完毕后，公司总股本为 278,320,842 股，扣减回购专用证券账户中股份 1,267,894 股后，股份总数为 277,052,948 股。公司按转增后的股数重新计算比较期间基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。

（三）变动合理性分析

（1）公司营业收入持续高速增长，2018 年至 2024 年复合增长率达到 96.79%。公司持续拓展产品布局，一方面加快产品迭代，另一方面推出有市场竞争力的新产品，业务规模不断扩大，2024 年公司营业收入达到 410,345.39 万元，同比增长 51.70%。

在薄膜沉积设备方面，实现产品销售收入 386,272.46 万元，同比增长 50.29%。其中，PECVD 系列产品作为公司核心产品，持续保持竞争优势，扩大量产规模，销售收入创历史新高；ALD 系列产品凭借国内工艺覆盖率先的优势，ALD SiCO、SiN、AlN 等工艺设备获得重复订单并已实现出货，持续扩大量产规模；HDPCVD 系列产品自通过客户端验证后，逐步放量；SACVD 系列产品持续拓展应用领域，量产规模不断扩大；Flowable CVD 系列产品取得了突破性进展，本年实现首台的产业化应用且复购设备再次通过验证。

在应用于三维集成领域的先进键合设备及配套量检测设备方面，实现产品销售收入 9,566.85 万元，同比增长 48.78%，其中：晶圆对晶圆混合键合设备、芯片对晶圆键合前表面预处理设备获得重复订单并扩大产业化应用，新推出的键合套准精度量测设备及键合强度检测设备通过客户验证。

随着公司产品及工艺覆盖度的持续提升，市场渗透持续加强，客户及市场认可度不断提升，客户群体进一步扩大，销售订单大幅度增长，截至 2024 年末，公司在手订单金额约 94 亿元，为后续业绩增长提供有力保障。

(2) 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 68,815.47 万元，同比增长 3.86%，主要原因为：1) 公司继续加大研发力度，保持细分领域内产品技术领先，不断丰富薄膜沉积设备及应用于三维集成领域设备产品的品类，拓宽工艺应用覆盖面，在新产品、新型平台的研发、验证及产业化应用等方面均取得了突破性成果。PECVD Bianca 产品，以及基于新型设备平台 (PF-300T Plus 和 PF-300M) 和新型反应腔 (pX 和 Supra-D) 的 PECVD Stack (ONO 叠层)、ACHM 等先进工艺设备，实现了批量出货，陆续通过客户验证。2024 年研发投入 75,597.63 万元，同比增加 18,002.75 万元，增长 31.26%。2) 2024 年公司毛利率为 41.69%，同比降低 5.43 个百分点，主要由于新产品及新工艺的收入占比大幅度增加，新产品及新工艺在客户验证过程成本相对较高，毛利率下降。

(3) 2024 年公司经营活动产生的现金流量净额-28,252.53 万元，较上年同期-165,734.27 万元大幅度收窄。主要原因为 2024 年销售商品、提供劳务收到的现金达到 541,581.11 万元，较上年同期增加 263,048.18 万元，增长 94.44%，其中预收货款对应的合同负债期末达到 298,273.65 万元，较 2023 年末的 138,152.46 万元增加 160,121.19 万元，增长 115.90%。

(4) 2024 年末总资产较期初增长 53.61%，主要系在手订单增加，业务规模扩大，存货大幅增长。公司 2024 年出货超过 1,000 个设备反应腔，期末发出商品余额 416,405.86 万元，较 2023 年末 193,387.32 万元增长 115.32%，为后续收入增长奠定良好基础。

七、核心竞争力的变化情况

2024 年度，公司的核心竞争力未发生不利变化。公司致力于研发和生产世界领先的高端半导体专用设备，始终坚持自主创新，持续为半导体行业和客户提 供具有竞争力的产品。公司建立了创新管理体制，形成了多项国际先进的核心技术，并在研发团队、技术积累和研发平台、市场拓展和售后服务等方面形成竞争优势，具体体现为：

（一）具有丰富的技术储备及国际先进的核心技术优势

公司通过自主研发，形成了一系列独创性的设计，构建了完善的知识产权体系并取得了多项自主知识产权。截至 2024 年末，公司累计申请专利 1,640 项（含 PCT），获得授权专利 507 项，其中发明专利 246 项。

公司先后承担了多项国家重大专项/课题，研发并推出的基于不同平台类型且支持不同工艺型号的 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 和 Flowable CVD 薄膜系列设备均已在客户端实现量产，在半导体薄膜沉积设备领域积累了多项研发及产业化的核心技术，构建了具有设备种类、工艺型号外延开发能力的研发平台，性能达到了国际同类设备水平，并持续迭代升级产品性能，快速响应客户先进技术需求。

公司面向国内半导体制造产业的实际需求和产线演进节奏，研制并推出了应用于三维集成领域的先进键合设备和配套的量检测设备，并积累了多项具有自主知识产权的核心技术。公司未来将保持高强度的研发投入，持续迭代升级、优化现有设备和工艺，不断推出面向未来发展需求的新工艺、新设备。

（二）优秀的技术研发及管理团队优势

公司已经建成了一支国际化、专业化的高端半导体专用设备技术研发及管理团队。公司立足核心技术研发，积极引进资深专业人才、自主培养科研团队。

公司国际化、专业化的高级管理团队、长效激励机制及具有竞争力的薪酬福利，吸引了大量具有丰富经验的国内外半导体设备行业人才加入公司，在整机设计、工艺开发、软件设计等方面做出突出贡献。公司自设立以来，自主培养本土科研团队，随着多项产品的研发成功，公司本土科研团队已成长为公司技术研发的中坚力量。截至 2024 年末，公司研发人员共有 648 名，占公司员工总数的 42.30%，研发人员中博士研究生 47 人，占比约 7.25%，硕士研究生 377 人，占比约 58.18%。公司的研发技术团队结构合理，分工明确，专业知识储备深厚，产线验证经验丰富，是奠定公司技术实力的基石，保障了公司产品的市场竞争力。2024 年，公司核心技术团队稳定，不存在重大不利变化。

（三）领先的行业地位及丰富的客户资源优势

公司以“建立世界领先的半导体设备公司”为愿景，通过在薄膜沉积设备及三维集成领域的先进键合设备及配套的量检测设备的技术积累和快速发展，较国内竞争对手形成显著先发优势，已经成为国内半导体设备行业的领军企业。

公司已与国内下游客户形成了较为稳定的合作关系。公司薄膜系列产品已批量发往国内集成电路晶圆厂产线。此外，公司致力于为客户提供三维集成领域全面的技术解决方案，目前应用于三维集成领域的系列产品研发和产业化已取得重大进展，产品陆续在客户端实现产业化应用。

（四）稳定的供应链及较低的运营成本优势

公司建立了完善的供应链管理体系，吸纳积累全球范围内的供应链资源，与关键供应商建立战略合作关系，搭建了稳定的供应链结构。通过对供应商进行阶段性的评估与考核，鼓励供应商在产品质量、交货期和成本控制等方面进行改善，从而提高企业竞争力。公司与供应商实时互动，协同产品创新，保持良好稳定的合作关系。

在产品方面，公司通过创新设计及与供应商密切合作，使产品具有模块化、易维护的特点，从而降低公司原材料采购成本。随着上游供应商的快速发展，给予了公司更多的采购选择。因此，公司相比其主要竞争对手在运营成本方面具有一定优势，随着产能的不断提升，降本优势将更加明显。

（五）提供定制化产品及高效的售后服务优势

公司针对客户提出的定制化的半导体专用设备具有快速响应能力，可以及时满足客户产线的客制化设备需求，这对下游晶圆制造厂能够快速扩充产能极其重要，由此建立和巩固与客户稳定的合作关系。公司主要客户的生产基地位于中国大陆，相较于国际竞争对手，公司管理和技术团队更贴近主要客户，能够提供高效的技术支持和售后服务，及时保障和满足客户需求。

八、研发支出变化及研发进展

（一）研发投入情况表

公司不断丰富薄膜沉积设备及应用于三维集成领域设备产品的品类，拓展工艺应用覆盖面，继续加大研发力度，2024 年度研发投入 75,597.63 万元，同比增长 31.26%，主要系职工薪酬及专业机构服务费等增加。具体如下：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	755,976,317.58	575,948,854.58	31.26
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	755,976,317.58	575,948,854.58	31.26
研发投入总额占营业收入比例（%）	18.42	21.29	减少 2.87 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发成果

公司始终在高端半导体专用设备领域深耕，并专注于薄膜沉积设备及三维集成领域设备的研发与产业化。2024 年，公司获批承担 2 项国家重大专项。截至 2024 年末，公司已先后累计承担 11 项国家重大专项/课题。

2024 年度，公司通过了工业和信息化部第六批专精特新“小巨人”企业审核，被授予专精特新“小巨人”企业称号，此外，公司凭借核心产品“化学气相沉积设备”获得“2024 年辽宁省制造业单项冠军企业”称号。上述认定是对公司技术创新能力和自主研发能力的充分肯定，也是公司科研能力和综合能力的体现。

公司拥有多项自主知识产权和核心技术。截至 2024 年末，公司累计申请专利 1,640 项（含 PCT）、获得专利 507 项；2024 年，公司新增申请专利 435 项（含 PCT）、新增获得专利 157 项。

2024 年度，公司获得的知识产权情况列表如下：

项目	2024 年度新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	283	56	1,131	246

项目	2024 年度新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
实用新型专利	120	101	440	260
外观设计专利	0	0	2	1
软件著作权	21	21	56	56
其他	32	0	67	0
合计	456	178	1,696	563

注 1：上表“其他”指 PCT 申请数量；

注 2：上表“累计数量”中“申请数”和“获得数”不包含已失效专利。

九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

十、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕424 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,161.98 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 71.88 元，共募集资金人民币 227,283.12 万元，扣除发行费用 14,523.40 万元（不含税），募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。前述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2022]139 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 50,920.76 万元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	212,759.73
本期发生额	项目投入	B1	47,727.00
	用于股份回购金额	B2	19,727.29
	利息收入净额	B3	1,398.13
	完结项目剩余资金永久补充流动资金	B4	5,385.70

项 目		序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	C1	140,095.76
	用于股份回购金额	C2	19,727.29
	利息收入净额	C3	6,839.80
	完结项目剩余资金永久补充流动资金	C4	8,855.72
期末募集资金余额		$D=A-C1-C2+C3-C4$	50,920.76
减：理财产品余额		E	
减：回购专用证券账户余额		F	
期末募集资金账户余额		$G=D-E-F$	50,920.76

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账户名称	银行账号	募集资金余额	存款方式	备注
中信银行股份有限公司 沈阳长白岛支行	拓荆科技股份有限公司	8112901012700838048	247,093,083.22	活期	-
中信银行股份有限公司 沈阳南站支行	拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司	8112901012100914131	-	活期	于 2024 年 7 月 1 日销户
中信银行股份有限公司 上海中信泰富广场支行	拓荆科技（上海）有限公司	8110201012401451243	-	活期	于 2024 年 7 月 31 日销户
中信银行股份有限公司 上海中信泰富广场支行	拓荆科技（上海）有限公司	8110201012601533201	62,443,095.48	活期	-
中信银行股份有限公司 沈阳南站支行	拓荆科技股份有限公司	8112901012500967954	48,506,902.54	活期	-
中信银行股份有限公司	拓荆创益（沈阳）半导体设	8112901011600967391	151,164,499.72	活期	-

募集资金专户开户行	账户名称	银行账号	募集资金余额	存款方式	备注
沈阳南站支行	备有限公司				
合 计			509,207,580.96	/	/

2024 年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十一、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，拓荆科技无控股股东和实际控制人，公司第一大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司 55,026,693 股股份，持股比例为 19.77%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司部分董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份，具体情况如下：

姓名	公司职务	直接持股数量（股）
吕光泉	董事长、核心技术人员（2024 年 12 月离任）	1,095,200
姜 谦	董事（2024 年 1 月离任）、核心技术人员（2024 年 10 月离任）	2,703,588
刘 静	董事、总经理	60,236
孙丽杰	副总经理（2024 年 1 月离任）	55,964
陈新益	副总经理、核心技术人员	18,904
宁建平	副总经理、核心技术人员	16,428
牛新平	副总经理、核心技术人员	16,428
许龙旭	副总经理	19,714
赵 曦	副总经理、董事会秘书	28,696

姓名	公司职务	直接持股数量（股）
杨小强	财务负责人	4,971

十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：

刘宪广

张贺



招商证券股份有限公司

2025 年 5 月 19 日